【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成19年8月23日(2007.8.23)

【公表番号】特表2007-505449(P2007-505449A)
【公表日】平成19年3月8日(2007.3.8)
【年通号数】公開・登録公報2007-009
【出願番号】特願2006-525332(P2006-525332)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｒ　13/658　(2006.01)
Ｈ０１Ｒ　12/22　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｒ　13/658
Ｈ０１Ｒ　23/68　３０２Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成19年7月4日(2007.7.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）前壁（４１０）を有するヘッダ本体（４０２）であって、前記前壁（４１０）が内面（４２２）と外面（４２４）との間に配置される複数の第１の通路および第２の通路（４１６、４１８）を有するヘッダ本体（４０２）と、
（ｂ）前記第１の通路（４１６）に挿入するために構成される複数の導電性ピン（４０４）であって、各導電性ピン（４０４）が前記内面（４２２）から延在する第１の端部（４５２）、前記第１の通路（４１６）に配置される中間部分および前記前壁（４１０）の前記外面（４２４）から延在する第２の端部（４５４）を有する複数の導電性ピン（４０４）と、
（ｃ）前記第２の通路（４１８）に挿入するために構成される複数のシールドブレード（４２８）であって、各シールドブレード（４２８）が前記内面（４２２）から延在する第１の端部（４６２）、前記第２の通路（４１８）に配置される中間部分および前記前壁（４１０）の前記外面（４２４）から延在する第２の端部（４６４）を有する複数のシールドブレード（４２８）と、を備えるヘッダコネクタ（４００）であって、
各導電性ピン（４０４）の前記第２の端部（４５４）は、先端が切り取られており、
前記導電性ピン（４０４）は、前記第１の通路（４１６）に完全に挿入されていないことと、
前記導電性ピン（４０４）は前記ヘッダ本体（４０２）にある間は実質的に静止したままであり、前記ヘッダコネクタ（４００）がプリント回路基板（３４）に組み付けられるとき、前記ヘッダコネクタ（４００）の各導電性ピン（４０４）は、前記第１の通路（４１６）の中で長手方向に可動であることと、を特徴とするヘッダコネクタ（４００）。
【請求項２】
（ａ）複数の表面実装パッド（３６）および複数の導電性バイア（３８）を備えるプリント回路基板（３４）と、
（ｂ）請求項１に記載のヘッダコネクタ（４００）と、
（ｃ）前記ヘッダコネクタ（４００）を前記プリント回路基板（３４）に保持するための手段と、を備え、

前記ヘッダコネクタ（４００）が前記プリント回路基板（３４）に組み付けられるとき、前記ヘッダコネクタ（４００）の各導電性ピン（４０４）は、前記ヘッダ本体（４０２）の前記前壁（４１０）に対して、前記第１の通路（４１６）において長手方向に移動して前記表面実装パッド（３６）に接触し、前記ヘッダコネクタ（４００）の前記シールドブレード（４２８）の前記第２の端部（４６４）は前記プリント回路基板（３４）の前記導電性バイア（３８）と嵌合する相互接続システム。

【請求項３】

（ａ）複数の表面実装パッド（３６）および複数の導電性バイア（３８）を備えるプリント回路基板（３４）を提供するステップと、

（ｂ）請求項１に記載のヘッダコネクタ（４００）を提供するステップと、

（ｃ）前記プリント回路基板（３４）に前記ヘッダコネクタ（４００）を組み付け、前記ヘッダ本体（４０２）の前記シールドブレード（４２８）が前記プリント回路基板（３４）の前記導電性バイア（３８）と嵌合し、前記ヘッダ本体（４０２）の前記導電性ピン（４０４）が前記プリント回路基板（３４）上の前記表面実装パッド（３６）と接触するように長手方向に移動するステップと、を含む相互接続システムの組み付け方法。